

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 8 日以书面和电话通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘伟先生
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天科合达半导体股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2018 年 9 月 28 日召开北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年9月13日